

Schichtstoffplattenresistenz 3

Stoffe die sofort mit einem nassen Tuch entfernt werden müssen. Anschließend muss die Oberfläche trocken gerieben werden.

| Substanz | chem. Formel |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| In Konzentrationen über etwa 10%: | |
| Aminosulfosäure | $\text{NH}_2\text{SO}_3\text{H}$ |
| Anorganische Säuren, z.B.: | |
| Arsensäure | H_3AsO_4 |
| Chromschwefelsäure | $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4$ |
| Flußsäure | HF |
| Königswasser | $\text{HNO}_3 + \text{HCl} = 1:3$ |
| Phosphorsäure | H_3PO_4 |
| Salpetersäure | HNO_3 |
| Salzsäure | HCl |
| Schwefelsäure | H_2SO_4 |
| Bromwasserstoff | HBr |

Aggressive Gase und Dämpfe, die zu einer Veränderung der HPL Plattenoberfläche führen.

| Gase und Dämpfe | chem. Formel |
|-----------------|---------------|
| Brom | Br_2 |
| Chlor | Cl_2 |
| Säuredämpfe | |
| Nitrosedämpfe | NxOy |
| Schwefeldioxyd | SO_2 |